

Výsledky posouzení způsobilosti kandidátů pro výzvu Společného podniku pro čipy na vybudování sítě kompetenčních center v oblasti polovodičů

12.9.2024 - | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Návazně na instrukci vyhlášenou MŠMT dne 10. července 2024 MŠMT obdrželo 1 návrh projektu, který vyjádřil zájem ucházet se o podporu ve výzvě Společného podniku pro čipy (dále též „Chips JU“) na vybudování celoevropské sítě kompetenčních center v oblasti polovodičů.

Podklady zaslané uchazečem, kterým je konsorcium subjektů vedené Vysokým učením technickým v Brně, byly posouzeny meziresortní komisí složenou ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR, která posoudila kvalifikační předpoklady uchazeče pro účast v mezinárodní výzvě vyhlášené Společným podnikem pro čipy.

Meziresortní komise se usnesla, že konsorcium vedené Vysokým učením technickým v Brně a jeho projekt „Czech Semiconductor Centre“ naplňuje požadované kvalifikační předpoklady a v mezinárodní výzvě vyhlášené Společným podnikem pro čipy může být označen jakožto způsobilý projekt z ČR. MŠMT za tímto účelem nejpozději do dne 2. října 2024 vydá úspěšnému konsorciu tzv. Letter of Intent, který je potřebný při hodnocení v mezinárodní výzvě Chips JU.

MŠMT upozorňuje, že Letter of Intent nezakládá právní vztah mezi MŠMT a uchazečem a není garancí, že projekt bude ze zdrojů MŠMT financován. Konečné rozhodnutí o financování úspěšných projektů provede za základě mezinárodního hodnocení Rada správních orgánů (Public Authorities Board) Společného podniku pro čipy.

MŠMT předpokládá, že pro český projekt, který bude na základě mezinárodního hodnocení Radou správních orgánů (Public Authorities Board) Společného podniku pro čipy vybrán k financování, vypíše výzvu k předkládání žádostí dle zákona 130/2002 Sb., v platném znění, na základě které bude moci být financován národní podíl.

<https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysledky-posouzeni-zpusobilosti-kandidatu-pro-vyzvu>